

## 2017 集成电路设计与制造国际研讨会会议通知

随着集成电路技术进步及全球化进程的加速，集成电路消费市场需求的持续增长，集成电路产业已是科技创新的龙头产业，产品升级换代加快、先进产能布局加强，新兴应用市场不断涌现，集成电路产业面临新的发展机遇。落实《国家集成电路产业发展推进纲要》要求，加强集成电路产、学、研、用协同创新，推动产业技术创新和融合发展。为此，北京电子学会、北京市电子科技情报研究所等将联合举办“2017 集成电路设计与制造国际研讨会”，旨在通过研讨和交流搭建产学研用交流平台，了解集成电路设计和制造领域发展动态、国际前沿技术和新兴市场前景，促进产业界和学术界之间的交流和创新研究。会议分主题报告和圆桌讨论，代表将在集成电路设计与制造发展和应用研究领域展开研讨和交流。

### 一、会议名称

2017 集成电路设计与制造国际研讨会

2017 International Conference On Integrated Circuit Design & Manufacture (ICDM2017)

### 二、组织机构

指导单位：北京市科学技术协会

主办单位：北京电子学会

承办单位：北京市电子科技情报研究所 北京电子学会半导体专委会

协办单位：北京大学软件与微电子学院 北方工业大学电子信息学院

大学生集成电路大赛组委会 北方芯云科技有限公司

支持媒体：《国外电子测量技术》《电子测量技术》《电子资讯时报》社

三、会议时间地点：2017 年 10 月 31 日 北京京仪大酒店

#### 四、会议范围及主题

- (一) 集成电路设计方法和 IP 核
- (二) 集成电路装备和制造
- (三) 集成电路市场应用

#### 五、投稿须知

1. 投稿要求：按照科技期刊要求双栏排版，有中英文题目、摘要，正文包含引言、结论，参考文献、作者简介，达到 4 页以上。

2. 投稿邮箱：[icdm2017@163.com](mailto:icdm2017@163.com)。

3. 文章将送至本会议技术委员会审稿，经审查后录用，优秀稿件推荐发表在科技核心期刊《电子测量技术》（正刊）及《国外电子测量技术》（正刊）上。

4. 每篇论文至少有一名作者到会宣读或者张贴论文。

#### 六、参会人员及报名方式

集成电路领域科研、技术人员，包括集成电路大赛参赛人员代表，中国电子学会青年会员，光电学会会员，以及相关高校、企业科研人员。

可以通过填写附件中的参会回执发送到 [icdm2017@163.com](mailto:icdm2017@163.com) 报名参会。

#### 七、会议费

600 元/人（含会议资料费、午餐）。住宿自理。

#### 八、联系方式

地 址：北京市东城区北河沿大街 79 号

电 话：010-64034890-253

邮 箱：[icdm2017@163.com](mailto:icdm2017@163.com)

联系人：黄璐



## 附件一：参会回执

|      |    |    |      |           |
|------|----|----|------|-----------|
| 姓名   | 单位 | 职务 | 手机   | 座机或其他联系方式 |
| 发票抬头 |    |    | 电子邮箱 |           |
| 备注   |    |    |      |           |

## 附件二：日程安排（拟）

| 上午：大会报告          |                 |                             |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 时间               | 内容              | 演讲人                         |
| 09:00-09:10      | 嘉宾介绍、领导致词       |                             |
| 09:10-09:50      | 集成电路技术热点和发展趋势   | 北京大学 张兴                     |
| 09:50-10:30      | 待定              | 新加坡南洋理工大学                   |
| 10:30-10:40      | 茶 歇             |                             |
| 10:40-11:20      | 待定              | 美国高智公司副总裁<br>Casey Tegreene |
| 11:20-12:00      | 人工智能与类脑芯片       | 中科院计算所 陈云霁                  |
| 下午：圆桌会议：集成电路设计会场 |                 |                             |
| 13:30-14:00      | 低功耗集成电路设计技术及应用  | 清华大学 王志华                    |
| 14:00-14:30      | 集成电路技术的生物医学应用   | 中科院半导体所 陈弘达                 |
| 14:30-15:00      | 集成电路 IP 核       | 灿芯创智微电子技术(北京)有限公司<br>吴汉明    |
| 15:00-15:20      | 茶 歇             |                             |
| 15:20-15:50      | 待定              | 北京工业大学                      |
| 15:50-16:20      | 集成电路市场分析和研究     | 北京市电子科技情报研究所                |
| 下午：圆桌会议：集成电路制造会场 |                 |                             |
| 13:30-14:00      | 半导体器件和工艺        | 中科院微电子所 陈大鹏                 |
| 14:00-14:30      | 集成电路装备产业布局      | 北方华创科技集团股份有限公司<br>黄亚辉       |
| 14:30-15:00      | 装备性能可靠性和一致性     | 中芯国际集成电路制造有限公司<br>康 劲       |
| 15:00-15:20      | 茶 歇             |                             |
| 15:20-15:50      | 氮化镓器件制作工艺中的关键问题 | 英诺赛科（珠海）科技有限公司<br>魏 进       |
| 15:50-16:20      | 微电子制造           | 燕东微电子                       |